

DATENBLATT



- **Intel Core Ultra 7 265KF**, 20 Kerne, 3.9 bis 5.5 GHz (Arrow Lake-S)
- **TRYX Panorama SE ARGB**, Wasserkühlung (360mm) schwarz mit Display
- **Thermal Grizzly Kryonaut**, Highend Wärmeleitpaste
- **32GB DDR5-6000 MHz** (2x16GB), Dual-Channel
- **NVIDIA GeForce RTX 5070**, 12GB GDDR7
- **ASUS TUF B860-Plus WIFI**, Intel B860, ATX, inkl. WLAN+Bluetooth
- **7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard**
- **2000 GB M.2 SSD (NVMe)**
- **ATX-Midi APNX V2**, schwarz
- **2x APNX FP2 PWM Lüfter ARGB**, schwarz
- **ADATA XPG Core Reactor II VE**, 850W, 80+ Gold, Modular
- Service24 basic

2.099,00 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Cube Panorama APNX Intel

Artikelnummer
201389

Konfigurationscode
2DZDH

Lieferzeit
● 7 - 9 Werkstage

Datum
08.12.2025

Gamer-PC Cube Panorama APNX V2 Intel
Basis: Intel Ultra 7
Grafik: ab RTX 5070

Powered by NVIDIA DLSS 3, ultra-effiziente Ada Lovelace Architektur und Raytracing

[Performance] Eine perfekte Gaming-Unterstützung erfährt das System durch die NVIDIA GeForce Grafikkarten-Serie der RTX Reihe. Unglaubliche Leistung für einen flüssigen Spielegenuss bei aktuellen Spieletiteln sorgen für ein Wunschlosglücklich-Niveau.

[Technik] Das System sieht nicht nur futuristisch aus, sondern ist auch zukunftsicher ausgestattet. Nur bewährte Bauteile etablierter Hersteller auf dem aktuellsten Stand der Technik, sorgen für eine hohe Langlebigkeit und bestmögliche Aufrüstbarkeit.

Für alle die das Besondere lieben!



Intel Core Ultra 7 265KF, 20 Kerne, 3.9 bis 5.5 GHz (Arrow Lake-S)

Prozessor

Typ	Ultra 7
Codename	Arrow Lake
Modell	Core Ultra 7 265KF
Sockel	1851
Anzahl Kerne	20
Anzahl Threads	20
Taktfrequenz	3.3 GHz
Turbo-Takt	5.5 GHz

TRYX Panorama SE ARGB, Wasserkühlung (360mm) schwarz mit Display

Kühlung

Typ	Wasserkühlung
Bauweise	360mm (triple)
Lautstärke	ab 10 dB(A)
Lautstärke (maximal)	28 dB(A)
Lüfter	3
Lüfterabmessung	120 x 120 x 25mm
Beleuchtung	ARGB
Material	Kupfer
wartungsfrei	ja
Farbe	schwarz

Sockel

115x / 1200	ja
1700	ja
1851	ja
AM4 / AM5	ja

Gewicht & Abmessungen

Höhe	2.7 cm
Breite	39.7 cm
Tiefe	12 cm

Thermal Grizzly Kryonaut, Highend Wärmeleitpaste

Kühlung

Typ	Luftkühlung
Lautstärke	-
Lautstärke (maximal)	-

Lüfter

Allgemein

Wärmeleitfähigkeit 12,5 W/mk

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-Channel

RAM

Typ	DDR5
Bauform	DIMM
Kapazität	32 GB
Speichertakt	6000 MHz
CAS Latzen	CL38
XMP	3.0
Spannung	1.35 V
Hitzeverteiler	Aluminium
Bauhöhe	35mm
Beleuchtung	nein
Farbe	schwarz

NVIDIA GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7

Spezifikation

Prozessorhersteller	NVIDIA
Prozessortyp	GeForce RTX
Grafikprozessor	GeForce RTX 5070
Prozessor-Taktfrequenz	2.16 GHz
Maximaler Turbotakt	2.51 GHz
Prozessorkerne	6144
Raytracing-Recheneinheiten	94 TFLOPS
Speichergröße	12 GB
Speichertyp	GDDR7
Speichertakt	21 Gbps
Speicherschnittstelle	192-Bit
HDCP-kompatibel	ja
DirectX Unterstützung	12
OpenGL Unterstützung	4.6
Kühlung	NVIDIA Referenz Kühlung
Lüfter	2
Schnittstelle	PCI-Express 5.0
PCIe-Stromanschluss	1x 16-Pin
Leistungsaufnahme	250 Watt
Empfohlene Netzteilleistung	650 Watt
benötigte Slots	2
VR-Ready	ja

Anschlüsse

VGA	nein
DVI	nein
HDMI	1
Mini-HDMI	nein
DisplayPort	3
Mini-DisplayPort	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein

Auflösung

max. Auflösung (DVI)	-
max. Auflösung (HDMI)	4096 x 2160 @ 60Hz
max. Auflösung (DisplayPort)	7680 x 4320 @ 120Hz
Maximale Displays	4

Gewicht & Abmessungen

Länge	30 cm
Breite	12 cm
Höhe	6 cm

ASUS TUF B860-Plus WIFI, Intel B860, ATX, inkl. WLAN+Bluetooth

Spezifikationen

Chipsatz	Intel B860
Sockel	1851
Format	ATX
Breite	24,4 cm
Länge	30,5 cm
Soundtyp	7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Soundchip	Realtek®
Netzwerktyp	Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Netzwerkchip	Realtek RTL8125B 2.5G
WLAN	ja
WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Bluetooth	ja
Bluetooth-Version	5.4
Speicherbänke	4
Speicherbelegung (max.)	256 GB
Speichertyp	DDR5
Speicherformate	4800 MHz bis 8666 MHz (O.C.)
Dual-Channel-Unterstützung	ja
Multi-GPU (Crossfire)	nein
Multi-GPU (SLI)	nein
RAID	0, 1, 5, 10
TPM	optional

Anschlüsse

PS/2	nein
VGA	nein
DVI	nein
HDMI	1
DisplayPort	1
Netzwerk (RJ45)	1 + WLAN (2 Antennen)
USB 2.0	2
USB 3.0	nein
USB 3.1 (Typ A)	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein
USB 3.2 (5Gbit) Typ A	3
USB 3.2 (10Gbit) Typ A	2
USB 3.2 (20Gbit) Typ C	1
Audio (Klinken)	5
S/PDIF (optisch)	1

Anschlüsse (intern)

SATA3 (6GB/s)	4
M.2 Sockel (x4 PCIe)	3
USB 3.1/3.2 (Gen2, 10GB/s)	1
USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s)	2 (für 4x USB3 Ports)
USB 2.0 (onboard)	4
Steckplätze PCIe 5.0 x16	1
Steckplätze PCIe 4.0 x16	1
Steckplätze PCIe 4.0 x16 (x4 mode)	1
CPU Lüfter Anschluss	2x 4-Pin
Zusatz Lüfter Anschluss	5x 4-Pin
24-Pin EATX Strom	1
8-Pin ATX 12V Strom	2
Front Audio Anschluss	ja
RGB Connector	1
ARGB Connector	3

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard

Anschlüsse und Schnittstellen

Mikrofon	1
Kopfhörerausgang	1
Subwoofer-Out	1

Spezifikationen

Soundchip	onboard
Soundtyp	7.1 Kanal

2000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

Kapazität	2000 GB
Schnittstelle	M.2 (PCIe)
Formfaktor	M.2 2280
Geschwindigkeit (lesen)	bis 3500 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben)	bis 3000 MB/s

Gewicht & Abmessungen

Länge	80 mm cm
Breite	22 mm cm
Gewicht	10 g kg

ATX-Midi APNX V2, schwarz

Design

Formfaktor	Midi-Tower
Materialien	Kunststoff, Stahl
Seitenfenster	ja
Beleuchtung	ja
Grundfarbe	schwarz
Dämmung	nein
Fronttür	nein
eingebaute Lüfter	1
Lüftertyp	140mm

Einbaumöglichkeiten

Hauptplatine	ATX, mATX, ITX
max. Grafikkartenlänge	45 cm
max. CPU-Kühler Höhe	16.5 cm
5.25 Zoll Schacht (extern)	nein
5.25 Zoll Schacht (intern)	nein
3.5 Zoll Schacht (extern)	nein

3.5 Zoll Schacht (intern, für HDD)	2
2.5 Zoll Schacht (intern, für SSD)	4
Multi-Schacht (2.5 oder 3.5 Zoll intern)	nein
mögliche Lüfter (hinten)	0
mögliche Lüfter (vorne)	3x 12cm oder 2x 14cm
mögliche Lüfter (Seitenteil)	nein
mögliche Lüfter (Deckel)	3x 12cm oder 2x 14cm

Gewicht & Abmessungen

Breite	30.5 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	50 cm
Gewicht	6.5 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

USB 2.0	0
USB 3.0	0
USB 3.2	2
Mikrofon	ja
Kopfhörerausgang	ja
Cardreader	nein
Einschaltknopf	ja
Resetknopf	ja
Lüftersteuerung	nein

2x APNX FP2 PWM Lüfter ARGB, schwarz

Allgemein

Durchmesser	120
-------------	-----

Design

Beleuchtung	ARGB
-------------	------

ADATA XPG Core Reactor II VE, 850W, 80+ Gold, Modular

Strom

Nennleistung	850W
Effizienz	91%
80 PLUS	80 PLUS GOLD
Format	ATX
Lüfter	120mm
Lautstärke (bei 20% Last)	10.1db(A) - super silent
Lautstärke (bei 50% Last)	12.8db(A) - super Silent
Lautstärke (bei 100% Last)	26.3db(A) - silent
Anzahl 12V Schienen	1
Modular	ja
Effizienz bei 100%	91.4 %

Anschlüsse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)	1
ATX 12V (4+4-pol.)	2
EPS 12V (8-pol.)	1
SATA Strom	6
PCIe Strom (6+2-pol.)	3

Energie

Max. Stromstärke (+12V)	70.8A
Max. Stromstärke (+5V)	22A
Max. Stromstärke (+3.3V)	22A
Max. Stromstärke (+5Vsb)	3A
Max. Stromstärke (-12V)	0.3A

Kombinierter Strom (+12V)	850W
Kombinierter Strom (+5V)	120W
Kombinierter Strom (+3.3V)	120W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15W
Kombinierter Strom (-12V)	3.6W

Gewicht & Abmessungen

Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8,6 cm
Gewicht	1,66 kg

Service24 basic

Allgemein

Garantie	24 Monate
Abholservice	6 Monate deutschlandweit
Service & Support	lebenslang
Expressbearbeitung	nein